技術フォーラム「大阪の中小企業の底力」

プレゼンテーション　プログラム　2012 年 12 月 1 日（土）

10:00~10:50　第１セッション

司会：大阪工業大学　塩田康友 君

1.　無脈動定量ポンプについて／　富士テクノ工業株式会社
2.　研究開発型ベローズの作製／　三元ラセン管工業株式会社
3. 革新的な高付加価値，工程短縮化絞り金属プレス金型／　株式会社　小西金型工学
4. 半導体レーザーによる焼入れ／　富士高周波工業株式会社
5. PCD（焼結ダイヤモンド）ダイシングブレード／　株式会社　新日本テック

10:50~11:10　休憩

11:10~12:00　第２セッション

司会：大阪工業大学　塩田康友 君

6. 異種金属接合（固相接合）と，レーザー複合溶射による表面改質を利用した金型の高度な耐摩耗の研究開発／　マツダ　株式会社
7. 高周波誘導加熱／　富士電子工業株式会社
8. 遠心分離装置　ハイブリットマグフィルター／　小堀鐵工株式会社
9.ガラス扉用コーナーフレームの紹介／　有限会社　大和製作所
10. 「ガルバリ 55」（55%アルミ亜鉛合金溶融めっき）／　弘陽工業株式会社

12:00~13:00　昼休み

13:00～13:50　第３セッション

司会：大阪府ものづくり B2B ネットワーク　大西順一 君

11. プリント基板の金型技術・プレス加工技術／　株式会社　藤原電子工業
12. パンチプレス活用による微細精密板金加工／　田中電工株式会社
13. アルミ素材の鏡面切削加工技術紹介／　株式会社　中田製作所
14. 低融点合金　U-アロイ／　株式会社　大阪アサヒメタル工場
15. 高温・高圧用グラファイト成形パッキン／　株式会社　デジック

13:50~14:10　休憩

14:10~15:10　第４セッション

司会：大阪府ものづくり B2B ネットワーク　大西順一 君

16. わが社の金属部品の精密切削加工技術と新しい取組について／　株式会社　中農製作所
17 小径・微細加工用品について／　株式会社　MPC
18. 環境に優しい高耐食性コーティング「ジコラム」処理／　理化工業株式会社
19. 環境低負荷型鋳造法「凍結鋳造法」／　株式会社　三共合金鋳造所
20. メカニカルシール／　株式会社　ユーコウ産業
21. 世界に１本しかない超硬切削工具／　株式会社　ソリッドツール

15:30~16:20　ポスターセッション（全企業）

ポスター展示のみ

22. 超小型抵抗溶接機　ミニミニ・ウエルダーのご紹介／　臼谷電子株式会社

（次ページへ続く）

23. 高剛性，高精度の横中ぐりフライス盤，フェーシングセンターなど各種専用機のユーザーニーズに沿った製品づくり／
株式会社　野村製作所
24. 溶融塩法による硬質セラミックコーティング／　株式会社　ケンテック
25. 株式会社　エフ・エー・テック
26. 有限会社　パナシア
27. 有限会社　ニーズ
28. 双葉塗装株式会社
29. 株式会社　松村合金ダイス研究所
30. 株式会社　ダイセン電子工業
31. UESEI
32. 株式会社　ジューコー
33. ナガオ　エンベンデッド　エンジニアリング
34. 共立電子産業株式会社
35. 菅工房合同会社
36. 大信機器株式会社
37. 長谷川技術開発

以上